

デジタルファクトリー通信

2024年5月～2024年6月



TEL 東京エレクトロン デバイス株式会社

ハイライト

6月 トピックス

1	【イベント】ロボットテクノロジー・ジャパンに出展いたします！
2	【再掲リクエスト】GaNパワー半導体について解説
3	【特集記事】製造業・物流でロボット導入が進まない理由とは？

5月 トピックス

1	【導入事例4選】 半導体業界に必須！サイバー攻撃から考えるこれからの対策
2	【資料紹介】 まるっと解説！ -半導体製造現場の人手作業のDX化-
3	【特集記事】 注目！AI時代の発展を支える半導体製造技術 「HBM (High Bandwidth Memory)」とは

ROBOT TECHNOLOGY JAPAN 2024 に出展！

会期：7/4(木)～7/6(土)

テーマ【人依存の工程をまるっと自動化】

人に依存した作業はまだ工場での製造工程や物流現場には残っています。この課題を解決するため、東京エレクトロン デバイスは工程管理プラットフォームTriMath製品を提供します。

日程：2024年07月04日(木)～2024年07月06日(土)
10:00～17:00

会場：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）
参加費：無料(招待券もしくは事前登録)
小間番号：ホールC C59



詳細はこちら

[ROBOT TECHNOLOGY JAPAN 2024 | inrevium](https://www.inrevium.com/robot-technology-japan-2024)

3つの注目デモ



1. 工程管理プラットフォーム TriMath
2. 異常検知・設備診断システム CX-D
3. 計数器・パーツカウンター



※画像をクリックすると直接サイトに移動します

ワイドバンドギャップ半導体の中でもSiCとともに注目が集まるGaNパワー半導体について解説します。

◆目次◆

1. GaN（窒化ガリウム）とは？
2. GaNパワー半導体の用途は？
3. GaNパワー半導体の課題は？

▼詳細はこちら

<https://www.inrevium.com/pickup/gan-power-semiconductor/>

【特集記事】 製造業・物流でロボット導入が進まない理由とは？

6-3

人依存の現場からの脱却するためロボット導入効果を深堀します。

- ➡人手作業の自動化が進まない現場にはどういった特徴があるのか
- ➡「課題に立ち向かう自動化技術」

この2点について技術目線で紐解きます。



目次

1. 自動化が進まない現場の特徴
作業を形式知化できていない場合
今の技術では実現できない場合
2. 人依存現場の課題に立ち向かう自動化技術
AI
ロボットハンド

▼ ロボットビジョンシステム カタログダウンロード

https://survey.zohopublic.com/zs/ZwCssN?_gl=1*85buch*_gcl_au*MjIwMTYwMTA1LjE3MTUwNzUzMjc

▼ 詳細はこちら

<https://www.inrevium.com/pickup/factory-automation/>

【導入事例4選】 半導体業界に必須！サイバー攻撃から考えるこれからの対策

5-1



※画像をクリックすると直接サイトに移動します

近年、サイバー攻撃が増加

半導体業界においてもセキュリティ対策は急務です
本インタビューでは、半導体業界の工場におけるリスクと対策をお話頂きました
攻撃を簡単に防御し更に信頼性をアップする運用と事例を紹介します

解決ポイント



EdgeIPS製品を導入

- ✓ ソフトのインストール不要
- ✓ ネットワーク工事なく低コスト

解決ポイント



Portable Inspectorを導入

- ✓ 装置出荷/導入 双方でチェック
- ✓ 持込みPCのチェック
- ✓ チェックレポートで信頼性アップ

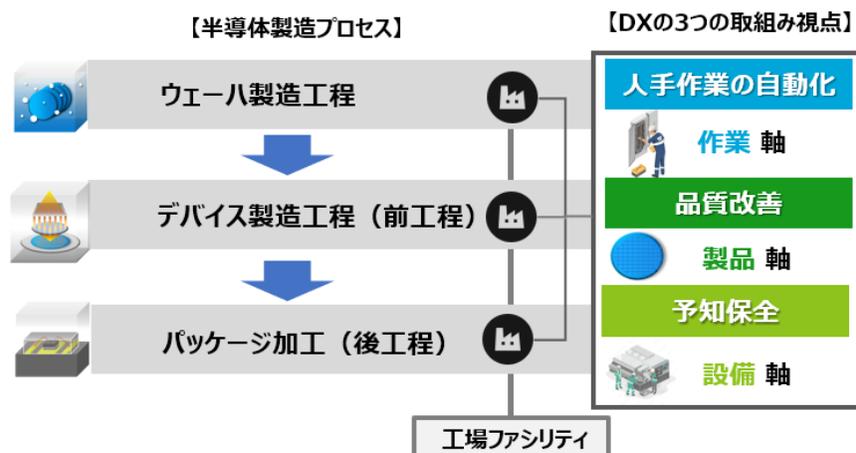
▼ 詳細記事を見る

<https://www.inrevium.com/pickup/txone/>

▼ 導入事例集はこちら

<https://survey.zohopublic.com/zs/IBC1JU>

製造業の中でも半導体業界は自動化が進みながら未だに人手に頼る工程が存在します
本資料では、設備データ活用で現場の人手作業をDX化する取組みをまるっと紹介します

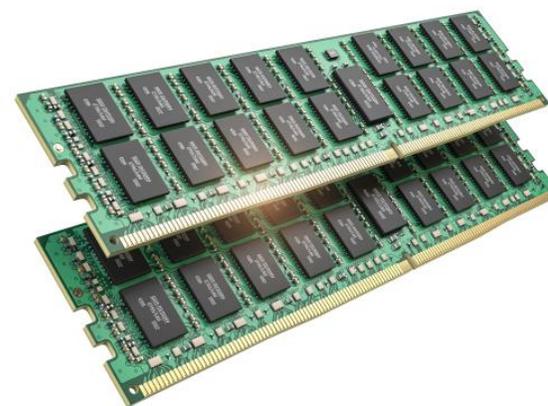


資料の内容

- ◆半導体製造工程とDXの取組み
- ◆3つのDX化業務
- ◆4つの現場をご紹介
 - 現場 1 製造プロセス監視
 - 現場 2 ウェーハ欠陥の原因調査
 - 現場 3 設備稼働監視作業
 - 現場 4 設備の安定稼働と故障検知

▼資料ダウンロード

<https://survey.zohopublic.com/zs/mMD3IT>



※画像をクリックすると直接サイトに移動します

先端半導体の技術の中でも微細化と並んで今後の半導体性能を大きく左右する、3次元実装技術。その構成技術である**HBM**について解説します。

◆目次◆

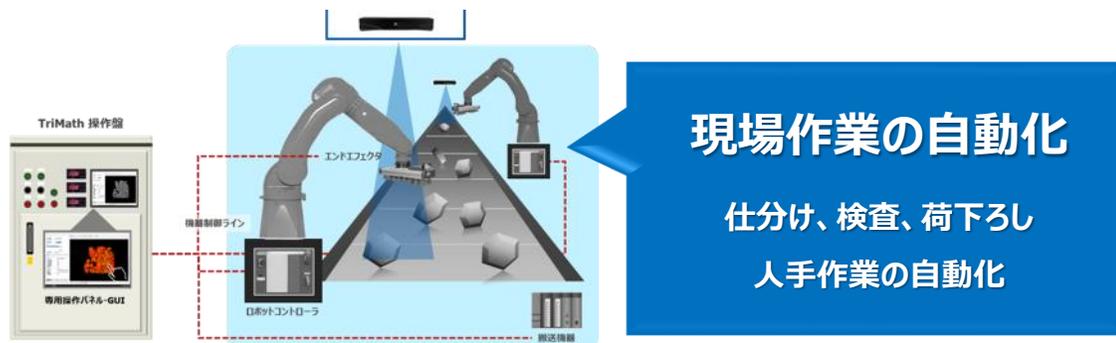
- [1] HBM（High Bandwidth Memory）とは
- [2] HBMの使用アプリケーション
- [3] HBMの課題と展望

▼詳細はこちら

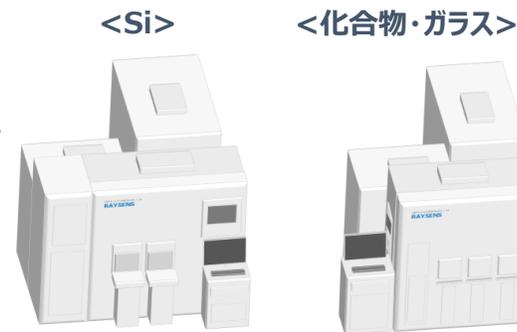
<https://www.inrevium.com/pickup/hbm/>

デジタルファクトリーソリューション

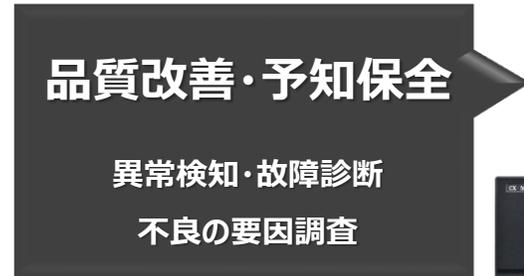
【成長型ビジョンオートメーションシステム TriMath】



【ウェ-ハ外観検査装置 RAYSENS】



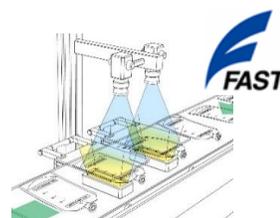
工場セキュリティ マルウェア/脆弱性対策



【時系列データ自動分析マシン CX-M】
【異常検知・設備診断システム CX-D】



【計測・検査ソリューション FAST】



【パーツカウンター めばかり君】



TED デジタルファクトリーソリューション 詳細一覧

詳しくはWEBで！ <https://www.inrevium.com/>

➤ [予知保全](#)

製品

- [異常検知・設備診断システム](#)
- [時系列データ自動分析マシン](#)
- [異常検知 組込AIソフトウェア](#)
- [CSVファイル 可視化・加工ツール（無料）](#)

サービス

- [モノづくりDX 計画作成講座](#)

ソリューション

- [AEセンサによる設備異常の予兆監視](#)

➤ [計測・検査](#)

ウェーハ欠陥検査装置

- [Si ウェーハ 欠陥検査装置](#)
- [SiCウェーハ 欠陥検査装置](#)
- [LT/LNウェーハ欠陥検査装置](#)
- [ガラスウェーハ 欠陥検査装置](#)
- [ウェーハ パターン 欠陥検査装置](#)

計数・計測機器

- [計数器・パーツカウンター](#)
- [温湿度モニタリングシステム](#)

画像処理製品

- [画像処理ライブラリ](#)
- [汎用画像処理装置](#)
- [位置決め装置](#)

画像処理ソリューション

- [金属プレス部品 外観検査](#)
- [薬液バッグ製造 外観検査](#)
- [カーボン繊維積層 異物検査](#)
- [3次元塗布検査](#)
- [不定形物への塗布経路補正](#)
- [ピッキングロボットの位置補正](#)

➤ [ロボット](#)

製品

- [ロボットビジョンシステム](#)
- [材料袋のデパレタイズロボット](#)
- [鋳物部品のピッキングロボット](#)
- [商品のピースピッキングロボット](#)
- [メッキ部品のハンドリングロボット](#)

ソリューション

- [洗濯機ピッキング・デパレタイズ](#)
- [室外機 ピッキング・仕分け](#)
- [鉱石 ピッキング・仕分け](#)
- [袋 ピッキング・デパレタイズ](#)